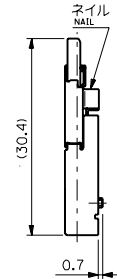
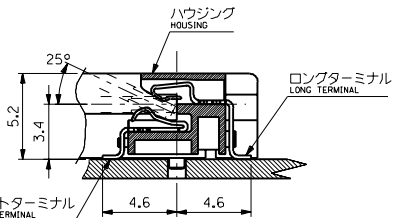


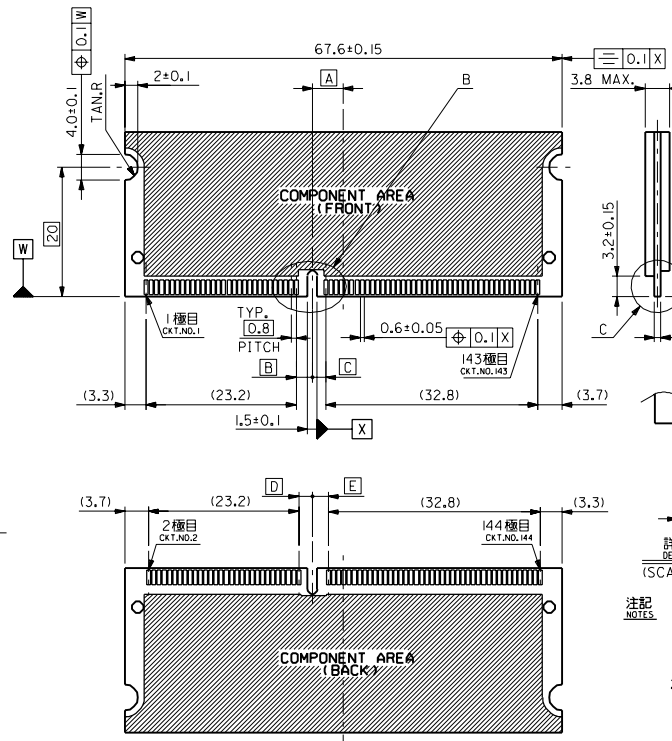
詳細 D
DETAIL D
(SCALE: 5-1)



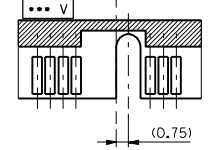
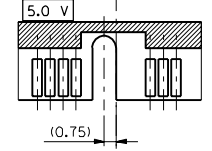
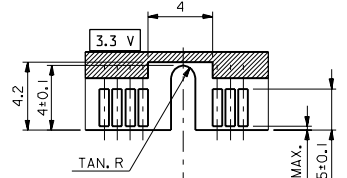
ネイル
NAIL



断面 A-A
SECTION A-A
(SCALE: 5-1)



推奨基板寸法
RECOMMENDED MATING BOARD CONFIGURATION
(THK: 1.0±0.1)



詳細 C
DETAIL C
(SCALE: 5-1)

詳細 B
DETAIL B
(SCALE: 5-1)

- 注記 NOTES
- 材料 MATERIAL
ハウジング : ガラス入りLCP、白色、UL94V-0
ターミナル : 焼青銅
TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE
ネイル : 黄銅
NAIL : BRASS
 - めっき仕様 PLATING
ターミナル : 金めっき 0.25μmMIN.
CONTACT AREA : GOLD 0.25μmMIN.
半田付部 : 半田めっき 1.0μmMIN.
SOLDER TAIL AREA : TIN-LEAD 1.0μmMIN.
下地めっき : ニッケルめっき 2.0μmMIN.
UNDER-PLATING : NICKEL 2.0μmMIN.
ネイル : 半田めっき : 2.0μmMIN.
TIN-LEAD : 2.0μmMIN.
 - テール平坦度は、0.1MAX.とする。
TAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAX.
ネイル平坦度は、0.1MAX.とする。
NAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAX.

1.75	2.85	1.35	3.25	4.05	***V	ハードトレイ (高さ9)	54142-1448
						ハードトレイ (高さ11)	54142-1445
						ハードトレイ (高さ11)	54142-1442
3.25	1.35	2.85	1.75	5.55	5.0V	ハードトレイ (高さ9)	54142-1447
						ハードトレイ (高さ11)	54142-1444
						ハードトレイ (高さ11)	54142-1441
2.5	2.1	2.1	2.5	4.8	3.3V	ハードトレイ (高さ9)	54142-1446
						ハードトレイ (高さ11)	54142-1443
						ハードトレイ (高さ11)	54142-1440
E	D	C	B	A	POWER SUPPLY	ハードトレイ	ENG.NO.

材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		MOLLEX JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		注記参照 SEE NOTES		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		適用電線範囲 WIRE RANGE		TITLE 名称	
適用径 INS. RANGE		適用径 INS. RANGE		0.8mm PITCH S.O.DIMM	
DRAWN BY		CHK'D BY		H'S'G ASS'Y 144CKT. (H=5.2)	
APP'D BY		DATE		DWG. NO.	
REVISION RECORD		REVISION RECORD		SD-54142-144	
GENERAL DIMENSIONS		GENERAL DIMENSIONS		REV	